

ひとわざ(一技)名: ベアチップ実装(Wireボンディング、COF)の狭ピッチ対応

1. 概要(200字目安)

1. Wireボンディング(COB)

- ・狭ピッチ (min35 $\mu$ m)、ループコントロール(低ループ、キャビティ構造などの段差)の対応が可能。
- ・樹脂封止の領域コントロールを行い、センサー面等の開口を確保致します。
- ・スタッドハンブ&レバリング対応可能。

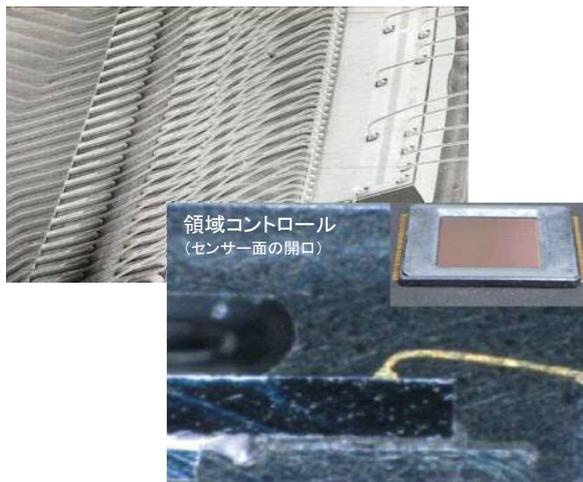
2. COF (リールtoリール実装) ※大型ライン保有: Total22, 000Kpcs生産能力

- ・狭ピッチ (min25 $\mu$ m) 対応が可能。
- ・COF+SMT対応可能(リールtoリール)

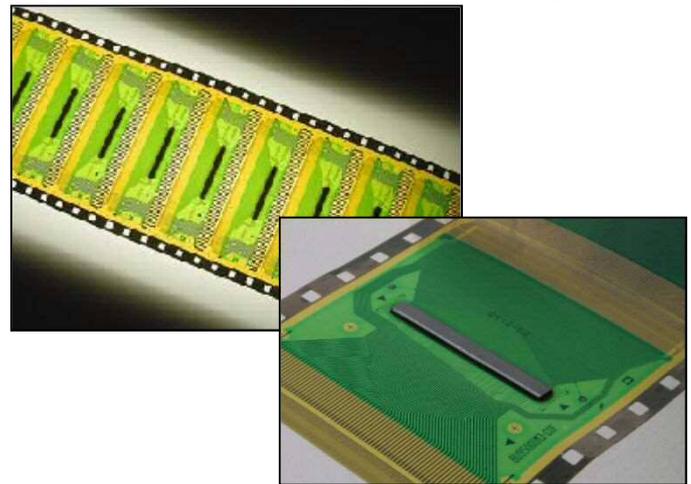
写真・図(要点説明)

【加工例】

①Wireボンディング実装と領域コントロール



②フィルム基板にベアチップをFCBIにより一括接続



2. 企業概況

会社名	株式会社ミスズ工業	代表者名	代表取締役 山崎泰三
		窓口担当	企画営業G 大槻 浩
事業内容	情報機器部品製造、電子情報部品製造	U R L	<a href="http://www.miszu.co.jp">http://www.miszu.co.jp</a>
主要製品	情報機器部品、精密金型、電子情報部品 等		
住所	〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪1536		
電話/FAX	0265-79-8866(代)/0265-79-8877	E-mail	<a href="mailto:ohtsuki-hiroshi@miszu.co.jp">ohtsuki-hiroshi@miszu.co.jp</a>
資本金(百万円)	400	設立年月日	1964年6月
		売上(百万円)	16236
		従業員数	439

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③取引実績 他)

- ① ISO9001 取得済み、ISO14001 取得済み
- ② COB:モジュールタイプにフィット COF:狭ピッチ&多pinのベアチップ実装の大量生産に適している。
- ③ 電子機器部品